

证券代码：300656

证券简称：民德电子

## 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-05

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：券商策略会、线上会议
参与单位名称	中欧基金、南方基金、银华基金、鹏华基金、汇添富基金、信达澳亚基金、平安基金、富国基金、嘉实基金、招商基金、金信基金、泓德基金、东方阿尔法基金、长城基金、兴全基金、万家基金、上银基金、华夏基金、广发基金、海富通、华安基金、华泰保兴、泰康基金、融通基金、建信基金、民生加银、长盛基金、华夏久盈基金、创金合信基金、国联基金、富荣基金、太平养老、太平洋资产、华宝信托、泰康基金、鹤禧投资、益昶资产、中泰安和投资、准锦投资、勤辰投资、淳辉资本、创华投资、盛熙基金、稻兴资本、中孚投资、宝弘资产、盘京投资、展博投资、招商证券自营、国信证券自营、第一创业自营、华创证券、国金证券、信达证券、中邮证券、东北证券、华福证券、华源证券、中信证券、国信证券、中泰证券、东财证券
时间	2026年6月15日—7月3日
地点	北京、上海、深圳，线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、AiDC 总经理：高健 董事会秘书：陈国兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、功率半导体行业近几年供需格局情况如何？</b></p> <p><b>答：2020~2022年：</b>受新能源汽车、光伏等需求拉动，叠加疫情影响下供应链扰动，功率半导体整体处于上升周期，国内多家晶圆厂新建或扩建功率半导体晶圆产线。</p> <p><b>2023~2025年：</b>伴随前期新增产能释放，叠加下游需求增速放缓，行业竞争加剧、产品价格持续走低，部分功率半导体产品价格一度跌至2022年高位的一半左右。</p> <p><b>2025年底以来：</b>国内成熟制程晶圆厂基本都处于满产状态，自2026年一季度开始陆续有晶圆厂上调价格；伴随今年二季度上游硅片厂普遍涨价后，国内成熟制程晶圆代工涨价面进一步扩大，行业步入上行周期。</p>

**需求端：**受 AI 带动电力需求增加，功率半导体器件需求增长明显，储能、新能源汽车等领域对功率器件的需求也保持较快增长；且之前行业低迷期，下游终端较少备库存，涨价后下游终端普遍积极备货。

**供给端：**自 2023 年以来受市场低迷影响，国内外成熟制程晶圆产能整体未有增长，台积电、三星等海外大厂陆续减少 6、8 英寸成熟制程产能，将资源和人力投向更高端的先进制程产能，国内规模较大的晶圆厂，近两年扩产也主要面向先进制程和高端模拟芯片，较少有功率半导体晶圆产能新建和扩产；不少之前在海外代工的设计公司均转向国内晶圆厂进行代工，使得国内成熟制程晶圆代工产能紧张。

**2、公司控股晶圆代工厂广芯微电子目前运营情况如何，今年是否有涨价？后续的扩产进度和规划是怎样？**

答：2025 年底至今，广芯微电子产品良率持续保持高位稳定，客户数量稳步增长，公司产能及订单均处于饱满状态。结合目前市场情况，广芯微电子于 2026 年 6 月开始对代工价格进行上调，涨价幅度在 10~20%。

广芯微电子项目占地约 150 亩，已建设用地 100 亩，其中，一期生产厂房规划产能为月产 10 万片 6 英寸硅基晶圆加工。公司一直在积极推进扩产工作，通过引进社会资本股权投资、新增银行融资、启动 10 亿元定增等渠道，不断增强广芯微电子的资金实力，并陆续和设备供应商签署采购协议，目前设备也在逐步进场调试。公司将尽快推进一期项目满产，并在适当时机启动二期项目建设。

**3、公司控股功率半导体设计公司广微集成目前运营情况如何？**

答：广微集成自 2024 年将核心产品 MOS 场效应二极管（MFER）切换至广芯微电子代工流片以来，随着客户验证通过，销量持续提升，从 2025 年初月销量约 1 千片提升至目前 1 万多片/月，并有望持续增长；除对已有产品进行不断迭代优化外，广微集成也在广芯微电子推进多个新产品工艺平台的开发，并在其他晶圆代工厂有少量 12 英寸 SGT-MOSFET 产品生产。

**4、公司参股晶圆原材料企业晶睿电子目前运营情况如何，今年是否有涨价？SOI 产品是否有量产，下游主要应用是什么？**

答：晶睿电子产品包括 4-8 英寸硅基外延片、MEMS 传感器用双抛片、SiC 外延片、SOI 等，2025 年底以来，晶睿电子一直处于满产满销状态，并逐步优化产品和客户，今年晶睿电子创单月营收历史新高，且毛利率转正。结合市场情况，晶睿电子 2026 年 6

	<p>月发布涨价函，涨价幅度约 15%，7 月 1 日起执行。另，晶睿电子今年已完成约 2 亿元股权融资，并新建单晶棒项目，预计年底或明年初投产，以缓解当前市场晶棒紧缺、交期久的问题。投产后，晶睿电子将成为国内较少实现硅片全产业链布局的企业（硅单晶棒—抛光片—外延片），有助于进一步增厚晶睿电子的利润率。</p> <p>晶睿电子是国内少数实现 SOI 产品量产的半导体材料企业，且具备自主知识产权；目前，SOI 产品下游主要覆盖 MEMS 传感器、航空航天抗辐照器件、高端功率器件等领域。</p> <p><b>风险提示：</b>本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026-07-05